

公司代码：688347

公司简称：华虹公司

华虹半导体有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、董事及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，具体方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.165 港币（含税），股息以港币计值和宣派，其中 A 股股息将以人民币支付，折算汇率以董事会宣派股息之日（不含当日）前一周的中国人民银行公布的港币对人民币中间价平均值 1 港币折合人民币 0.90736 元计算，金额为每股人民币 0.150 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 0.165 港币（含税）金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议通过

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

公司治理特殊安排情况：

本公司为红筹企业

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	华虹公司	688347	不适用
港股	香港联交所主板	华虹半导体	01347	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）	钱蕾
办公地址	中国上海市浦东新区哈雷路288号	中国上海市浦东新区哈雷路288号
电话	86-21-38829909	86-21-50809908
电子信箱	IR@hhgrace.com	IR@hhgrace.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

华虹半导体是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色 IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务从而实现收入和利润。

2、研发模式

公司的研发策略主要依靠自主研发对各类工艺平台进行技术创新与升级。公司为规范并加强项目运行过程的管理，建立了较为完善的研发体系及项目管理流程，明确项目组成员职责及目标，从项目的立项、研发及结项全过程进行规范，并通过新项目立项申请流程、产品质量先期策划规程等进行分阶段、系统性管理。

3、采购模式

公司采用集中采购制度，由采购部门向合格供应商采购半导体晶圆代工及配套服务所需的原物料、设备及技术服务等。为提高生产效率、减少库存囤积、加强成本控制，公司已建立完善的采购管理体系和规程：

库存类请购由物料计划部门根据生产计划、库存量和交货周期提出；非库存类请购需求由请购部门在预算额度内根据实际需求以请购单方式提出。

收到请购需求后，采购部门核对请购单准确性，确认无误后依据采购需求比选供应商，通过询价、报价、议价或招标等作业程序，与供应商签署采购订单并负责交期跟催。物流部门负责来料的收存工作，品保部门负责来料质量检验。

对于工程、设备和服务采购，采购人员凭请购部门签核的完工通知单和或验收签核文件办理请款作业；对于其他项目采购，采购人员凭系统收货确认在请款系统中开立请款申请单。请款申请单核准后，采购人员连同发票交由财务进行付款作业。

4、生产模式

公司根据销售预测规划产能并确定主生产计划（即先期生产计划，依据市场预测与产能情况规划产品生产计划），按客户订单需求进行投产，具体如下：

公司产品从生产策划到成品出库主要经过四个阶段，分别为生产策划阶段、生产准备阶段、生产过程管理阶段以及产品入库阶段。

（1）生产策划阶段

在生产策划阶段，销售部门提供从客户处获取的未来的业务预测以及与客户达成的商业计划，计划部门按照业务预测以及产能规划，根据客户需求、客户订单、产能和工艺技术准备情况，制定主生产计划。

（2）生产准备阶段

在生产准备阶段，物料规划部门根据主生产计划制定原材料计划并协同采购部门及时准备原材料。生产计划部门根据主生产计划及原材料计划制定投产计划。

（3）生产过程管理阶段

在生产过程管理阶段，生产部门根据主生产计划及投产计划安排和管理生产，生产计划部门监督生产周期、生产进度、产量等指标，品质管控部门负责产品的质量管控。

（4）产品入库阶段

在产品入库阶段，完成全部生产流程的产品经检验合格后入库。

5、销售模式

公司采用直销模式开展销售业务，与客户直接沟通并形成符合客户需求的解决方案，最终达成与客户签订订单。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

从宏观情况来看，全球经济增长乏力，局部地缘冲突带来的能源危机叠加货币波动等因素的影响，导致全球消费动力不足，再叠加前两年产能紧张造成的备货行为，集成电路产品库存积压严重。据 IBS 2024 年 1 月统计数据显示，2023 年全球半导体市场销售额约为 5,054 亿美元，同比下降 9%。

晶圆代工行业源于半导体产业链的专业化分工，晶圆代工企业不涵盖芯片设计环节，专门负责晶圆制造，为芯片产品公司提供晶圆代工服务。晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，

需要大量的资本支出和人才投入，具有较高的进入壁垒。

中国大陆晶圆代工行业起步较晚，但在国家政策的支持下，随着国内经济的发展和科学技术水平的提高，以及终端应用市场规模的扩大，国内芯片设计公司对晶圆代工服务的需求日益提升，中国大陆晶圆代工行业实现了快速的发展。

随着下游应用场景新需求的不断涌现，半导体产品种类不断增多。为满足市场对于产品功能、性能等特性的差异化需求，IDM 厂商与晶圆代工厂商等涉及晶圆制造环节的企业不断研发创新晶圆制造工艺技术，并演进形成了差异化的制造工艺。晶圆制造工艺大致可分为先进逻辑工艺与特色工艺。

与沿着摩尔定律不断追求晶体管缩小的先进逻辑工艺不同，特色工艺不完全追求器件的缩小，而是通过持续优化器件结构与制造工艺最大化发挥不同器件的物理特性以提升产品性能及可靠性。特色工艺主要用于制造功率器件 MCU、智能卡芯片、电源管理芯片、射频芯片、传感器等，上述产品被广泛应用于新能源汽车、工业智造、通讯、物联网、新能源、消费电子等众多应用领域。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

华虹公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有行业领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套。根据全球纯晶圆代工企业最新公布的 2023 年销售额情况排名，华虹公司位居全球第五位，在中国大陆企业中排名第二。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）半导体晶圆代工行业在新技术发展情况

全球信息化、数字化、智能化、网联化等市场发展趋势，带动了全球半导体技术的不断迭代与创新，对除了逻辑电路以外的其他集成电路和半导体器件类型都提出了更高的技术要求，嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理等多元化特色工艺技术得以快速发展以适应不断更新的市场需求。

（2）半导体晶圆代工行业在新产业的发展情况

随着新能源汽车、工业智造、通讯、物联网、新能源等新兴产业的蓬勃发展，芯片作为智能硬件的核心部件，其应用几乎无处不在，在新产业的诞生和发展过程中扮演了重要角色。与此同时，新产业的发展也会对芯片的性能、功耗、尺寸等不断提出新的需求，促进晶圆制造技术的突破和工艺平台的丰富，为半导体晶圆代工行业带来新的机遇。

（3）半导体行业在新业态与新模式发展情况

半导体中游产业在发展初期，由于相关技术被少数国际大型企业掌握，而生产所需的设备、材料、工艺技术又具有高度专业性等原因，行业内企业主要采用垂直整合模式（IDM 模式）。伴随产业规模扩大、技术进步与市场多样化需求的兴起，半导体中游逐渐由设计、制造以及封装测试只能在公司内部一体化完成的 IDM 模式演变为多个专业细分产业，行业开始呈现垂直化分工格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	76,226,351,074.40	47,876,614,340.83	59.21	38,337,909,658.33
归属于上市公司股东的净资产	43,354,252,355.10	19,844,793,693.32	118.47	17,081,376,645.04
营业收入	16,231,874,037.72	16,785,718,004.90	-3.30	10,629,677,535.99
归属于上市公司股东的净利润	1,936,230,415.48	3,008,612,623.47	-35.64	1,659,997,402.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,614,028,155.76	2,570,341,094.34	-37.21	1,083,222,860.10
经营活动产生的现金流量净额	5,104,987,996.61	5,524,293,421.02	-7.59	3,905,485,050.10
加权平均净资产收益率(%)	6.49	16.30	减少9.81个百分点	10.27
基本每股收益(元/股)	1.31	2.31	-43.29	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.30	2.29	-43.23	1.26
研发投入占营业收入的比例(%)			增加1.48个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,374,300,427.29	4,469,653,503.96	4,108,654,270.64	3,279,265,835.83
归属于上市公司股东的净利润	1,044,228,236.78	544,490,281.00	95,834,147.30	251,677,750.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,001,305,489.22	412,830,361.78	49,698,534.61	150,193,770.15
经营活动产生的现金流	1,012,192,400.58	1,229,633,777.16	1,220,561,131.90	1,642,600,686.97

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	59,636
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,914
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
香港中央结算(代 理人)有限公司 (HKSCC NOMINEES LIMITED)	4,925,983	620,805,449	36.17			未 知		境 外 法 人

上海华虹国际公司 (Shanghai Hua Hong International, Inc.)	0	347,605,650	20.25			无		境外法人
鑫芯 (香港) 投资有限公司 (Xinxin (Hongkong) Capital Co., Limited)	0	178,705,925	10.41			无		境外法人
联和国际有限公司 (Sino-Alliance International, Ltd.)	0	160,545,541	9.35			无		境外法人
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	48,334,249	2.82	48,334,249		无		境内非国有法人
国新投资有限公司	23,076,923	23,076,923	1.34	23,076,923		无		国有法人
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	23,076,923	23,076,923	1.34	23,076,923		无		国有法人
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金 (有限合伙)	13,461,538	13,461,538	0.78	13,461,538		无		境内非国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	9,615,384	9,615,384	0.56	9,615,384		无		国有法人
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	8,155,000	0.48	8,155,000		无		国有法人

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1.华虹国际、华虹集团、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司均受上海市国资委控制。2 鑫芯（香港）投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金一期”）通过巽鑫（上海）投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司（以下简称“华芯投资”）作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金一期”）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）进行管理。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
<p>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</p>	<p>无</p>

存托凭证持有人情况

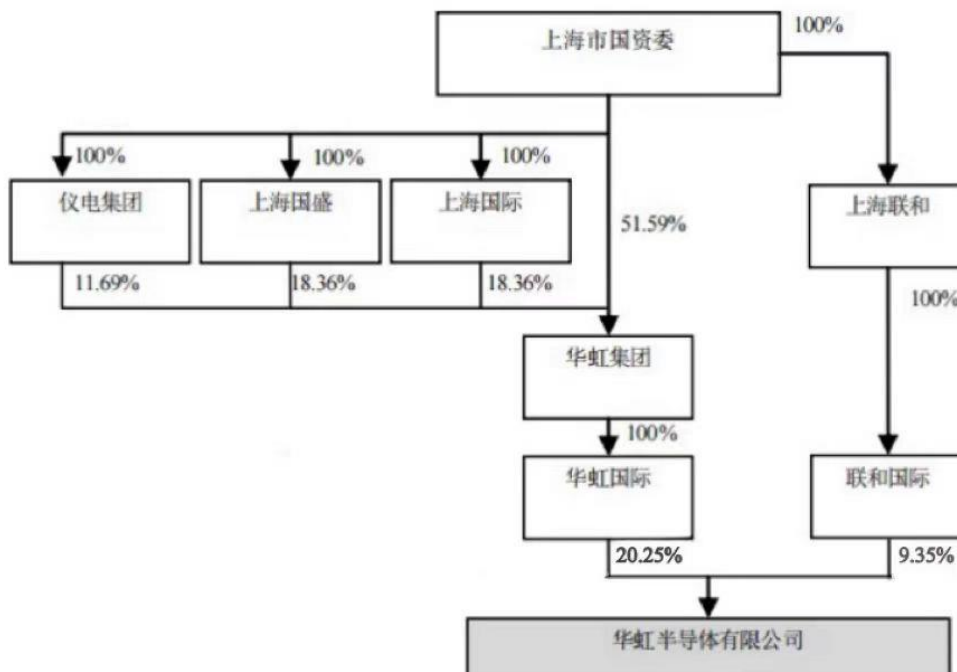
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团实现营业收入人民币 162.32 亿元，比上年同期下降 3.30%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 19.36 亿元，比上年同期下降 35.64%。报告期内，本集团的经营活动所得现金为人民币 51.05 亿元，较上年同期下降 7.59%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 63.96 亿元，较上年同期下降 4.96%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用